半導體設備產品比較表

Product model								Mode I	RLA-	RLA-	\$02_	VES-	Model	DI A_	DI A	VE_	VE_	VE_	VE_	CI II
		<u>VF-5900</u>	<u>VF-5700</u>	<u>VF-5300</u>	<u>VF-5100</u>	<u>VF-3000</u>	<u>VF-1000</u>	200	3100	1200	S02- 12-F	<u>VFS-</u> <u>4000</u>	Mode I 206A	RLA- 3100-V	RLA- 4106-V	<u>VF-</u> 5300HLP	<u>VF-</u> 5300H	<u>VF-</u> <u>3000H</u>	<u>VF-</u> 3000HS	CLH Series
	I	Τ.	Ι.		ı	ı	I _		ı	ı	I _	ı				ı		ı		
晶阑尺寸	φ300mm	0	0				0	-			0	-	-	-			-			0
	φ200mm		-	0	0	0	0	0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0
	最大ф150mm	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0
	-200	100	F0.	-	-	-	25	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	- 1	25
批量大小 [最大存放數/系統]	φ300mm	100	50	150	150		25				100					100				25
	φ200mm		-			50	25	125	1	1		-	-	1	1		75	-	50	200
	最大 		-	200	150	75	50	150	1	1	-	-	-	1	1	100	50	50	75	200
	其他 (矩形基板等)		-		-	-	-		-	-	-	40	800			-	-	-		25
	晶圓 (基板)	0	0	0	0	0	-		0		0	0	-	0	0	0	0	0	0	
傳輸系統	盒式堆料器	-	-	0	-	-	_	-	-	_	-	-	_		-	0	0	-	-	
		0	0	-			-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	_	
	FOUP開口器 FOUP儲料器	0	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	_	-
	. SOT BELLIAM																			
	直立式爐管	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
系統	横型爐管	<u> </u>	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	燈退火系統	-	-	-	-	-	-		0	0	-	-		0	0	-	-	-	-	0
	潔淨烤箱系統	-	-	-	-	-	-	-			0	-		-	-	-	-	-	-	-
	大口徑直立式爐管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			-	-	-	-	_	-
	SiC功率半導體	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-
							l .					l .				l .		l .		
半導體	退火	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	0	-	0	-
	熱氧化	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0	-	0	-
	LPCVD (SiN, Poly-Si (Non-Doped, P-Doped) TEOS, HTO)	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	活化退火			0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-
	雜質擴散	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
	聚酰亞胺固化	0	0	0	0	0	0		-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	吸雜	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
	燒結/合金	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SiC功率半導體	活化退火	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
	熱氧化	·	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
	氮化/氧氮化	Ŀ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
	LPCVD (TEOS)	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	POA	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-
	接觸退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
	I		ı		1	1	ı		1	1	1	ı				ı		ı		
MEMS	熱氧化	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	LPCVD	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	効気ル	1	1	~	I _	I _	_		1	1	1	l				l		l	, ,	
VCSEL	熱氧化	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	接觸退火		-	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-		-	-	-	-	-
PV (光電)	雜質擴散		-	-	-	-	-	0	-			-	0	-	-	-	-	-	- 1	
	熱氧化	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
	ANTE TO							J					J							
包装	聚酰亞胺固化		0	-			-				0	0				-			-	
-A																				
FPD	固化 (聚酰亞胺固化)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
	(聚酰亞胺固化) 活化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	脱氫	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	熔塊燒製	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	金屬接觸退火	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-
											<u> </u>									$\overline{}$

© JTEKT Thermo Systems Corporation